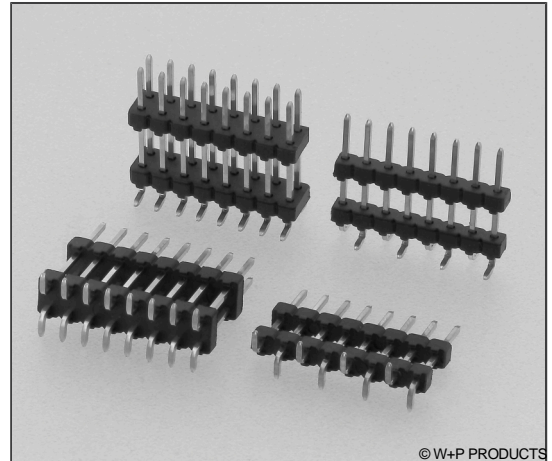


# 3533 / 3133

## SMT-Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, stehend, 1-/2-reihig SMT Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical, Single/Double Row

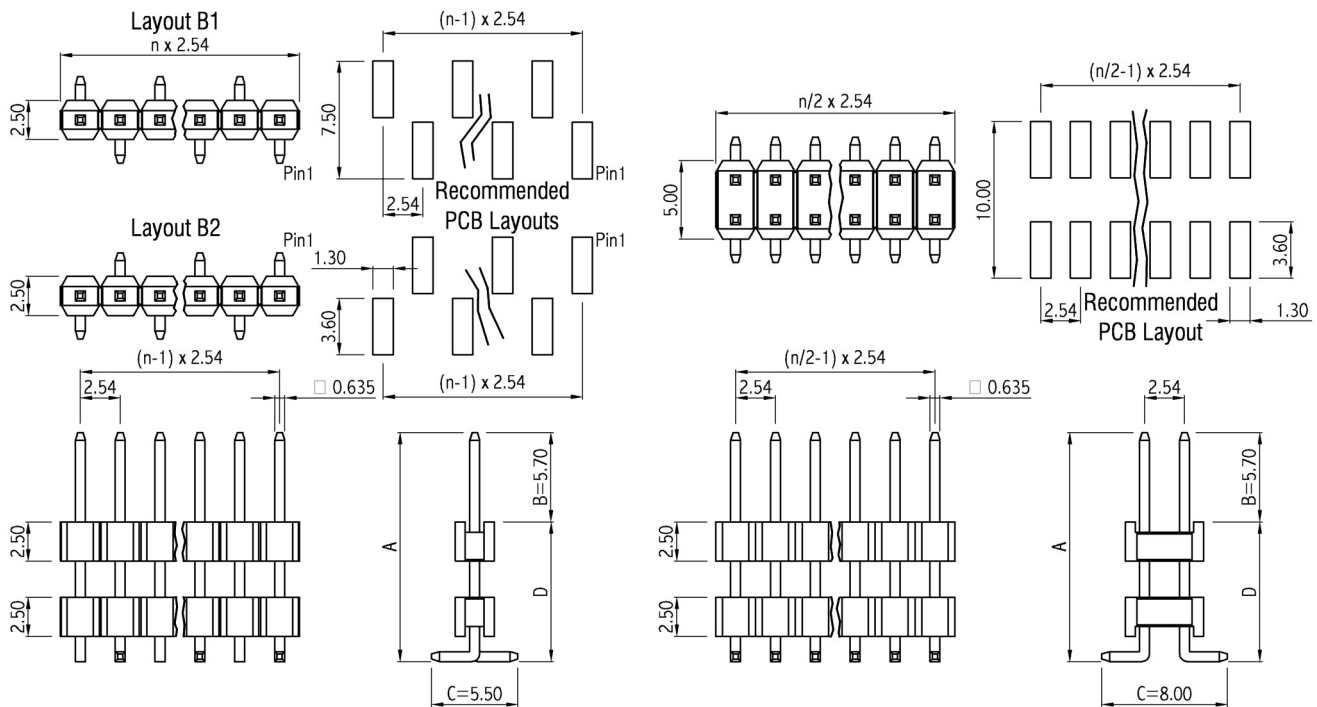
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV DC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**1531 1532 3490 3491** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Packaging*
<b>3133</b>	<b>16</b>	<b>020</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>ST</b>
Thermisch gerissene Kontakte <i>Electro-strictioned contacts</i>	16 A=15,80 D=10,10mm	003-050 Einreihig <i>Single row</i>	00 Vergoldet <i>Gold plated</i>	0 Für Serie 3133 <i>For series 3133</i>	ST PPST PPTR (Option)
3533 Einreihig <i>Single row</i>	17 A=17,90 D=12,20mm	004-100 Zweireihig <i>Double row</i>	10 0,25µm Gold <i>0.25µm gold plated</i>	1 Layout B1 für Serie 3533 <i>Layout B1 for series 3533</i>	
3133 Zweireihig <i>Double row</i>	18 A=19,70 D=14,00mm		50 Verzinkt <i>Tin plated</i>	2 Layout B2 für Serie 3533 <i>Layout B2 for series 3533</i>	
	19 A=20,90 D=15,20mm				
	20 A=23,00 D=17,30mm				

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.  
*More pin length and plating options on request.*

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*  
**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*  
**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an order example - please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

